

we[®] PÂTE THERMIQUE



3.5G

NE SÈCHE
PAS

UTILISATION
FACILE

we[®] PÂTE THERMIQUE

Idéale pour faciliter les transferts de chaleur, la pâte thermique We vous permet de réduire fortement la température de votre processeur. En offrant une meilleure dissipation et un excellent refroidissement, vous pouvez ainsi améliorer les performances et la durabilité de votre processeur.

Avec son bouchon, la pâte ne sèche pas. Vous pouvez donc l'utiliser plusieurs mois après l'ouverture.

Avec sa seringue de 3.5g et sa petite spatule, la pâte thermique We est très simple à utiliser !

Caractéristiques techniques :

- Seringue de 3.5g
- Conductivité : > 3.8 W/m-K
- Température de fonctionnement : -30° jusqu'à 180°
- Composition : 30% silicone, 20% carbone, 50% oxyde de métal



CODE	COULEUR	DIMENSIONS PACK (en mm)	GENCOD
WEPATHERM	Rouge et blanc 	109*158	 3 13044901414727